

2011-2015年中国IC先进 封装行业深度调研与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2011-2015年中国IC先进封装行业深度调研与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/baozhuang1110/483271900M.html>

【报告价格】纸介版6800元 电子版7000元 纸介+电子7500元

【出版日期】2011-10-14

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

报告说明:

博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国IC先进封装行业深度调研与投资前景研究报告》共十八章。首先介绍了中国IC先进封装行业的概念，接着分析了中国IC先进封装行业发展环境，然后对中国IC先进封装行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国IC先进封装行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国IC先进封装行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

IC先进封装主要指IC载板封装,主要包括BGA、CSP、FC、LGA型封装,应用领域主要包括手机、内存、PC、网络通信、消费类电子等诸多领域。先进封装技术由于其更小的面积、更低的成本,未来必将对传统封装进行全面的替代。先进封装的增长潜力远远高于传统封装行业,是全球各大封装未来发展的主要方向。

第一章 IC封装产业相关概述
第一节 IC封装涵盖
第二节 IC封装类型阐述
第三节 明日之星——TSV封装
第二章 2011年世界IC封装产业运行态势分析
第一节 2011年世界IC封装业运行环境浅析
第二节 2011年世界IC封装运行现状综述分析
第三节 2011年世界IC封装重点企业运行分析
第四节 2011-2015年世界IC封装业趋势探析
第三章 2011年中国IC封装行业市场运行环境解析
第一节 2011年中国宏观经济环境分析
第二节 2011年中国IC封装市场政策环境分析
第三节 2011年中国IC封装市场技术环境分析
第四章 2011年中国IC封装产业整体运行新形势透析
第一节 2011年中国IC封装产业动态聚焦
第二节 2011年中国IC封装产业现状综述
第三节 2011年中国IC封装产业差距分析
第四节 2011年中国IC封装产思考

第五章 2011年中国IC封装技术研究

第一节 2011年中国IC封装技术热点聚焦

第二节 高端IC封装技术

第六章 2011年中国高端IC-3D封装市场探析（3D-IC封装）

第一节 3D集成系统分析

第二节 2011年中国高端IC-3D封装发展总况

第三节 高端IC-3D封装研究进展

第四节 3D-IC集成封装系统（SiP）的可行性研究

第七章 2011年中国IC封装测试领域深度剖析

第一节 2011年中国IC封装测试业运行总况

第二节 新型封装测试技术

第八章 2007-2011年中国集成电路制造行业数据监测分析

第一节 2007-2011年中国集成电路制造行业规模分析

第二节 2011年一季度中国集成电路制造行业结构分析

第三节 2007-2011年中国集成电路制造行业产值分析

第四节 2007-2011年中国集成电路制造行业成本费用分析

第五节 2007-2011年中国集成电路制造行业盈利能力分析

第九章 2011年中国IC封装产业运行新形势透析

第一节 2011年中国IC封装产业运行综述

第二节 2011年中国IC封装产业变局分析

第三节 金融危机对中国IC封装业影响及应对分析

第四节 2011年中国IC封装业面临的挑战分析

第五节 对发展我国IC封装业的思考

第十章 2011年中国IC封装细分市场运行分析

第一节 手机IC封装市场

第二节 手机基频封装

第三节 智能手机处理器产业与封装

第四节 手机射频IC

第五节 PC领域先进封装

第十一章 2011年中国封装用材料运行分析

第一节 金线

第二节 IC载板

第十二章 2011年中国分立器件的封装发展透析

第一节 半导体产业中有两大分支

第二节 分立器件的封装及其主流类型

第三节 2011年中国分立器件的封装现状综述

第十三章 2011年中国IC封装产业竞争新格局探析

第一节 2011年中国IC封装竞争总况

第二节 2011年中国IC封装产业集中度分析

第三节 2011-2015年中国IC封装竞争趋势分析

第十四章 2011年中国半导体（集成电路）封装重点企业运营财务状况分析

第一节 长电科技（600584）

第二节 深圳赛意法微电子有限公司

第三节 南通富士通微电子股份有限公司

第四节 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司

第五节 英特尔产品（成都）有限公司

第六节 无锡菱光科技有限公司

第七节 恒宝股份有限公司

第八节 南京汉德森科技股份有限公司

第九节 深圳市比亚迪微电子有限公司

第十节 常州市欧密格电子科技有限公司

第十五章 2011年中国芯片封装重点企业关键性财务指标分析

第一节 安靠封装测试（上海）有限公司

第二节 沛顿科技（深圳）有限公司

第三节 淄博凯胜电子技术有限公司

第四节 河南鼎润科技实业有限公司

第五节 盟事达智能卡技术（深圳）有限公司

第十六章 2011年中国封装材料企业运营竞争性指标分析

第一节 汉高华威电子有限公司

第二节 厦门惠利泰化工有限公司

第三节 福建易而美光电材料有限公司

第四节 无锡创达电子有限公司

第五节 鼎贞（厦门）系统集成有限公司

第六节 无锡市江达精细化工有限公司

第七节 陕西华电材料总公司

第八节 无锡嘉联电子材料有限公司

第十七章 2011-2015年中国IC封装业前景预测分析

第一节 2011-2015年中国IC封装业前景预测

第二节 2011-2015年中国IC封装产业新趋势探析

第三节 2011-2015年中国IC封装市场前景预测

第四节 2011-2015年中国IC封装市场盈利预测

第十八章 2011-2015年中国IC封装业投资价值研究

第一节 2011年中国IC封装产业投资概况

第二节 2011-2015年中国IC封装投资机会分析

第三节 2011-2015年中国IC封装投资风险预警

第四节 专家投资观点

图表目录

图表 1 全球各国（地区）IC市场占有率

图表 2 全球IC载板市场规模与历年增长率（单位：百万美元）

图表 3 2006年全球IC载板产品类别

图表 4 世界主要有机IC封装基板的大型生产厂家

图表：2006-2011年国内生产总值

图表：2006-2011年居民消费价格涨跌幅度

图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2006-2011年年末国家外汇储备

图表：2006-2011年财政收入

图表：2006-2011年全社会固定资产投资

图表：2011年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力

图表：2011年房地产开发和销售主要指标完成情况

图表21 IC封装的管理标准IPC/JEDECJ-STD-033B.1

图表 22 中国集成电路各产业链产值比重

图表 23 中国IC封装测试业厂商竞争格局

图表24 键合前单晶圆上的对准标记

图表25 3D-IC集成

- 图表26 晶圆设计规则发展趋势
- 图表27 3D-IC集成Sip示意图
- 图表28 中间层中的IPD示意图
- 图表29 中间层版图
- 图表30 热/机械和电测试芯片
- 图表31 带有热、机械和电测试芯片的中间层
- 图表32 有机BT树脂衬底的顶部和底部（内部）版图
- 图表33 支撑3DICSIP的PCB的版图
- 图表34 用于电、热和机械测量的PCB版图
- 图表35 切割后的PCB
- 图表36 S11、S22和S12的3D-ICTSV测试装置
- 图表37 使用各种热源的最高结温与芯片堆叠数量之间的关系
- 图表38 测量300mm晶圆上3D-ICSip的TSV热特性的测试装置（背部研磨之前）
- 图表39 存储芯片堆叠中Cu填充TSV的3D非线性热应力分析
- 图表40 (a) 位于TSV中部的SiO₂；(b) Ta势垒层；(c) Cu填充TSV
- 图表41 2007-2011年我国集成电路制造行业企业数量增长趋势图
- 图表42 2007-2011年我国集成电路制造行业亏损企业数量增长趋势图
- 图表43 2007-2011年我国集成电路制造行业从业人数增长趋势图
- 图表44 2007-2011年我国集成电路制造行业资产规模增长趋势图
- 图表45 2011年一季度我国集成电路制造行业不同类型企业数量分布图
- 图表46 2011年一季度我国集成电路制造行业不同所有制企业数量分布图
- 图表47 2011年一季度我国集成电路制造行业不同类型企业销售收入分布图
- 图表48 2011年一季度我国集成电路制造行业不同所有制企业销售收入分布图
- 图表49 2007-2011年我国集成电路制造行业产成品增长趋势图
- 图表50 2007-2011年我国集成电路制造行业工业销售产值增长趋势图
- 图表51 2007-2011年我国集成电路制造行业出口交货值增长趋势图
- 图表52 2007-2011年我国集成电路制造行业销售成本增长趋势图
- 图表53 2007-2011年我国集成电路制造行业费用使用统计图
- 图表54 2007-2011年我国集成电路制造行业主要盈利指标统计图
- 图表55 2007-2011年我国集成电路制造行业主要盈利指标增长趋势图
- 图表56 2010年手机射频相关公司收入统计
- 图表57 封装尺寸比较

图表58 尺寸与热特性对比

图表59 部分功率器件封装尺寸

图表60 江苏长电科技股份有限公司主要经济指标

图表61 江苏长电科技股份有限公司盈利指标走势图

图表62 江苏长电科技股份有限公司偿债指标走势图

图表63 江苏长电科技股份有限公司运营指标走势图

图表64 江苏长电科技股份有限公司成长指标走势图

图表65 深圳赛意法微电子有限公司主要经济指标走势图

图表66 深圳赛意法微电子有限公司经营收入走势图

图表67 深圳赛意法微电子有限公司盈利指标走势图

图表68 深圳赛意法微电子有限公司负债情况图

图表69 深圳赛意法微电子有限公司负债指标走势图

图表70 深圳赛意法微电子有限公司运营能力指标走势图 单位：次

图表71 深圳赛意法微电子有限公司成长能力指标走势图

图表72 南通富士通微电子股份有限公司主要经济指标

图表73 南通富士通微电子股份有限公司盈利指标走势图

图表74 南通富士通微电子股份有限公司偿债指标走势图

图表75 南通富士通微电子股份有限公司运营指标走势图

图表76 南通富士通微电子股份有限公司成长指标走势图

图表77 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司主要经济指标走势图

图表78 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司经营收入走势图

图表79 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司盈利指标走势图

图表80 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司负债情况图

图表81 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司负债指标走势图

图表82 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司运营能力指标走势图 单位：次

图表83 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司成长能力指标走势图

图表84 英特尔产品（成都）有限公司主要经济指标走势图

图表85 英特尔产品（成都）有限公司经营收入走势图

图表86 英特尔产品（成都）有限公司盈利指标走势图

图表87 英特尔产品（成都）有限公司负债情况图

图表88 英特尔产品（成都）有限公司负债指标走势图

图表89 英特尔产品（成都）有限公司运营能力指标走势图 单位：次

- 图表90 英特尔产品（成都）有限公司成长能力指标走势图
- 图表91 无锡菱光科技有限公司主要经济指标走势图
- 图表92 无锡菱光科技有限公司经营收入走势图
- 图表93 无锡菱光科技有限公司盈利指标走势图
- 图表94 无锡菱光科技有限公司负债情况图
- 图表95 无锡菱光科技有限公司负债指标走势图
- 图表96 无锡菱光科技有限公司运营能力指标走势图 单位：次
- 图表97 无锡菱光科技有限公司成长能力指标走势图
- 图表98 恒宝股份有限公司主要经济指标
- 图表 99 恒宝股份有限公司盈利指标走势图
- 图表 100 恒宝股份有限公司偿债指标走势图
- 图表 101 恒宝股份有限公司运营指标走势图
- 图表 102 恒宝股份有限公司成长指标走势图
- 图表103 南京汉德森科技股份有限公司主要经济指标走势图
- 图表104 南京汉德森科技股份有限公司经营收入走势图
- 图表105 南京汉德森科技股份有限公司盈利指标走势图
- 图表106 南京汉德森科技股份有限公司负债情况图
- 图表107 南京汉德森科技股份有限公司负债指标走势图
- 图表108 南京汉德森科技股份有限公司运营能力指标走势图 单位：次
- 图表109 南京汉德森科技股份有限公司成长能力指标走势图
- 图表110 深圳市比亚迪微电子有限公司主要经济指标走势图
- 图表111 深圳市比亚迪微电子有限公司经营收入走势图
- 图表112 深圳市比亚迪微电子有限公司盈利指标走势图
- 图表113 深圳市比亚迪微电子有限公司负债情况图
- 图表114 深圳市比亚迪微电子有限公司负债指标走势图
- 图表115 深圳市比亚迪微电子有限公司运营能力指标走势图 单位：次
- 图表116 深圳市比亚迪微电子有限公司成长能力指标走势图
- 图表117 常州市欧密格电子科技有限公司主要经济指标走势图
- 图表118 常州市欧密格电子科技有限公司经营收入走势图
- 图表119 常州市欧密格电子科技有限公司盈利指标走势图
- 图表120 常州市欧密格电子科技有限公司负债情况图
- 图表121 常州市欧密格电子科技有限公司负债指标走势图

图表122 常州市欧密格电子科技有限公司运营能力指标走势图 单位：次

图表123 常州市欧密格电子科技有限公司成长能力指标走势图

图表124 安靠封装测试（上海）有限公司主要经济指标走势图

图表125 安靠封装测试（上海）有限公司经营收入走势图

图表126 安靠封装测试（上海）有限公司盈利指标走势图

图表127 安靠封装测试（上海）有限公司负债情况图

图表128 安靠封装测试（上海）有限公司负债指标走势图

图表129 安靠封装测试（上海）有限公司运营能力指标走势图 单位：次

图表130 安靠封装测试（上海）有限公司成长能力指标走势图

图表131 沛顿科技（深圳）有限公司主要经济指标走势图

图表132 沛顿科技（深圳）有限公司经营收入走势图

图表133 沛顿科技（深圳）有限公司盈利指标走势图

图表134 沛顿科技（深圳）有限公司负债情况图

图表135 沛顿科技（深圳）有限公司负债指标走势图

图表136 沛顿科技（深圳）有限公司运营能力指标走势图 单位：次

图表137 沛顿科技（深圳）有限公司成长能力指标走势图

图表138 淄博凯胜电子技术有限公司主要经济指标走势图

图表139 淄博凯胜电子技术有限公司经营收入走势图

图表140 淄博凯胜电子技术有限公司盈利指标走势图

图表141 淄博凯胜电子技术有限公司负债情况图

图表142 淄博凯胜电子技术有限公司负债指标走势图

图表143 淄博凯胜电子技术有限公司运营能力指标走势图 单位：次

图表144 淄博凯胜电子技术有限公司成长能力指标走势图

图表145 河南鼎润科技实业有限公司主要经济指标走势图

图表146 河南鼎润科技实业有限公司经营收入走势图

图表147 河南鼎润科技实业有限公司盈利指标走势图

图表148 河南鼎润科技实业有限公司负债情况图

图表149 河南鼎润科技实业有限公司负债指标走势图

图表150 河南鼎润科技实业有限公司运营能力指标走势图 单位：次

图表151 河南鼎润科技实业有限公司成长能力指标走势图

图表152 主要经济指标走势图

图表153 经营收入走势图

图表154 盈利指标走势图

图表155 负债情况图

图表156 负债指标走势图

图表157 汉高华威电子有限公司主要经济指标走势图

图表158 汉高华威电子有限公司经营收入走势图

图表159 汉高华威电子有限公司盈利指标走势图

图表160 汉高华威电子有限公司负债情况图

图表161 汉高华威电子有限公司负债指标走势图

图表162 汉高华威电子有限公司运营能力指标走势图 单位：次

图表163 汉高华威电子有限公司成长能力指标走势图

图表164 厦门惠利泰化工有限公司主要经济指标走势图

图表165 厦门惠利泰化工有限公司经营收入走势图

图表166 厦门惠利泰化工有限公司盈利指标走势图

图表167 厦门惠利泰化工有限公司负债情况图

图表168 厦门惠利泰化工有限公司负债指标走势图

图表169 厦门惠利泰化工有限公司运营能力指标走势图 单位：次

图表170 厦门惠利泰化工有限公司成长能力指标走势图

图表171 福建易而美光电材料有限公司主要经济指标走势图

图表172 福建易而美光电材料有限公司经营收入走势图

图表173 福建易而美光电材料有限公司盈利指标走势图

图表174 福建易而美光电材料有限公司负债情况图

图表175 福建易而美光电材料有限公司负债指标走势图

图表176 无锡创达电子有限公司主要经济指标走势图

图表177 无锡创达电子有限公司经营收入走势图

图表178 无锡创达电子有限公司盈利指标走势图

图表179 无锡创达电子有限公司负债情况图

图表180 无锡创达电子有限公司负债指标走势图

图表181 无锡创达电子有限公司运营能力指标走势图 单位：次

图表182 无锡创达电子有限公司成长能力指标走势图

图表183 鼎贞（厦门）系统集成有限公司主要经济指标走势图

图表184 鼎贞（厦门）系统集成有限公司经营收入走势图

图表185 鼎贞（厦门）系统集成有限公司盈利指标走势图

- 图表186 鼎贞（厦门）系统集成有限公司负债情况图
- 图表187 鼎贞（厦门）系统集成有限公司负债指标走势图
- 图表188 无锡市江达精细化工有限公司主要经济指标走势图
- 图表189 无锡市江达精细化工有限公司经营收入走势图
- 图表190 无锡市江达精细化工有限公司盈利指标走势图
- 图表191 无锡市江达精细化工有限公司负债情况图
- 图表192 无锡市江达精细化工有限公司负债指标走势图
- 图表193 陕西华电材料总公司主要经济指标走势图
- 图表194 陕西华电材料总公司经营收入走势图
- 图表195 陕西华电材料总公司盈利指标走势图
- 图表196 陕西华电材料总公司负债情况图
- 图表197 陕西华电材料总公司负债指标走势图
- 图表198 陕西华电材料总公司运营能力指标走势图 单位：次
- 图表199 陕西华电材料总公司成长能力指标走势图
- 图表200 无锡嘉联电子材料有限公司主要经济指标走势图
- 图表201 无锡嘉联电子材料有限公司经营收入走势图
- 图表202 无锡嘉联电子材料有限公司盈利指标走势图
- 图表203 无锡嘉联电子材料有限公司负债情况图
- 图表204 无锡嘉联电子材料有限公司负债指标走势图
- 图表 205 2011-2015年中国IC封装市场规模预测
- 图表 206 2011-2015年中国IC封装市场盈利预测

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/baozhuang1110/483271900M.html>